

中国半导体行业协会半导体分立器件分会

中半器协 [2018]002 号

第十二届中国半导体行业协会半导体分立器件年会暨 2018 年中国半导体器件技术创新及产业发展论坛 第二轮会议通知

自 2018 年 1 月 15 日中国半导体行业协会以“中半协[2018]001 号”文发出《第十二届中国半导体行业协会半导体分立器件年会暨 2018 年中国半导体器件技术创新及产业发展论坛》第一轮会议通知以来，来自全国各地的产、学、研、用等单位积极支持，踊跃投稿，现会议的准备工作已经就绪，就会议细节和论文录用情况通知如下。

一、会议特邀报告

国家集成电路产业投资基金有限公司总经理	丁文武 先生
西安电子科技大学副校长	郝跃 院士
中国电子科技集团公司原副总经理	赵正平 研究员
中国电子科技集团公司第十三研究所副所长	蔡树军 研究员
中国电源学会理事长	徐德鸿 教授
电子科技大学集成电路研究中心主任	张波 教授
贵州大学大数据与信息工程学院副院长	丁召 教授

二、会议组织机构

主办单位：中国半导体行业协会 贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会

承办单位：中国半导体行业协会半导体分立器件分会

贵州大学

西安电子科技大学

贵州民族大学

专用集成电路重点实验室

河北普兴电子科技股份有限公司

贵阳国家高新技术产业开发区创业服务中心

中国电子科技集团公司第十三研究所

协办单位：西安电子科技大学微电子学院

陕西半导体先导技术中心

宽禁带半导体材料山西省重点实验室

重庆师范大学

合肥锐拓科技信息服务有限公司

贵阳凯希博众会议会展服务有限公司
 《半导体技术》编辑部
 《微纳电子技术》编辑部

支持单位：



三、会议日程

1. 此次会议共录用论文摘要 187 篇（见附件），论文摘要都已经收入《论文集》，并将在参会者到会注册时发给每位参会者。希望每篇论文摘要（或论文）至少有一位作者参加会议。

由于来稿很多，研讨会时间有限，我们将根据具体情况选择安排在会上作报告的论文，并在事前与作者联系。

2. 7 月 23 日在贵阳高新银乾和悦酒店报到。会议议程安排如下：

时 间	地 点	主 题
7 月 24 日上午	贵阳国际生态会议中心 C 厅	开幕式、特邀报告
7 月 24 日下午	贵阳国际生态会议中心 C 厅	特邀报告
7 月 25 日上午	贵阳高新银乾和悦酒店三楼会议室	技术研讨会分会场（一）
7 月 25 日下午	贵阳高新银乾和悦酒店三楼会议室	
7 月 25 日上午	贵阳高新银乾和悦酒店三楼会议室	技术研讨会分会场（二）
7 月 25 日下午	贵阳高新银乾和悦酒店三楼会议室	

四、会议时间、地点

1.会议时间：2018 年 7 月 23 日贵阳高新银乾和悦酒店报到，24 日、25 日开会。

2.会议地点：贵阳高新银乾和悦酒店位于观山湖区湖滨路 6 号，距贵阳高铁站（贵阳北站）约 3 公里，距离贵阳站约 12 公里，距贵阳龙洞堡机场约 24 公里。

会务组联系方式：

陆皓：13832163057；E-mail:luhao4168@vip.126.com；

李永：13933075237；0311-87091519；

传真：0311-87091477 E-mail: polaris13@vip.163.com；csiadd@126.com

